



2024年12月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

2024年11月11日

上場会社名 タツモ株式会社

上場取引所 東

コード番号 6266 URL <https://tazmo.co.jp/irlibrary/#irlib-report01>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 佐藤 泰之

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 吉國 久雄

TEL 086-239-5000

配当支払開始予定日

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2024年12月期第3四半期の連結業績(2024年1月1日～2024年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年12月期第3四半期	24,739	30.0	4,601	91.3	4,524	68.2	3,094	101.1
2023年12月期第3四半期	19,034	12.2	2,405	74.1	2,690	34.4	1,539	7.9

(注) 包括利益 2024年12月期第3四半期 3,233百万円 (46.3%) 2023年12月期第3四半期 2,211百万円 (3.9%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年12月期第3四半期	211.27	
2023年12月期第3四半期	105.44	

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年12月期第3四半期	48,065	23,005	47.1	1,545.57
2023年12月期	47,428	20,095	41.7	1,350.22

(参考) 自己資本 2024年12月期第3四半期 22,672百万円 2023年12月期 19,767百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年12月期		0.00		24.00	24.00
2024年12月期		0.00			
2024年12月期(予想)				30.00	30.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2024年12月期の連結業績予想(2024年1月1日～2024年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	36,000	27.8	4,600	25.9	4,500	15.7	3,060	29.8	209.48

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
新規 社 (社名) 、 除外 社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 無
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2024年12月期3Q	14,842,354 株	2023年12月期	14,836,691 株
期末自己株式数	2024年12月期3Q	186,297 株	2023年12月期	196,237 株
期中平均株式数 (四半期累計)	2024年12月期3Q	14,647,170 株	2023年12月期3Q	14,596,735 株

添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.3「1. 経営成績等の概況(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(重要な後発事象)	8
(四半期連結貸借対照表に関する注記)	9
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	9
(セグメント情報等の注記)	10
3. 補足情報	11
(受注状況)	11

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第3四半期連結累計期間における経営環境は、地政学リスクの高まり、原材料の高騰や不安定な為替相場など、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

当社グループが属する半導体業界におきましては、AI用半導体需要の増加によりアドバンスドパッケージ用装置の引き合いは強いものの、パワー半導体需要の鈍化により設備投資計画を延期する動きが見られました。

このような状況のなか当社グループは、中長期的な成長に向けて、顧客ニーズに対応した装置の開発や生産活動に注力してまいりました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は247億39百万円（前年同期比30.0%増）、営業利益46億1百万円（前年同期比91.3%増）、経常利益45億24百万円（前年同期比68.2%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益30億94百万円（前年同期比101.1%増）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

(プロセス機器事業)

半導体装置部門につきましては、一部で装置の検収に遅れが発生しているものの概ね計画通りに推移しており、売上高は99億64百万円（前年同期比129.4%増）となりました。

搬送装置部門につきましては、半導体メーカーの設備投資が鈍化している影響を受け、売上高は58億62百万円（前年同期比4.5%減）となりました。

洗浄装置部門につきましては、ウェーハメーカーの設備投資が鈍化している影響はあるものの、遅れていた案件も徐々に検収が進み売上高は37億56百万円（前年同期比44.2%増）となりました。

コーター部門につきましては、遅延していた装置の検収が進み、売上高は18億55百万円（前年同期比31.8%増）となりました。

以上の結果、プロセス機器事業の売上高は214億38百万円（前年同期比47.9%増）、営業利益44億91百万円（前年同期比92.5%増）となりました。

(金型・樹脂成形事業)

金型・樹脂成形事業につきましては、スマートフォンやパソコン向けの需要が落ち込み、コネクタメーカーの在庫調整が長引いていることから、売上高は4億94百万円（前年同期比56.5%減）、営業損失2億17百万円（前年同期は19百万円の営業利益）となりました。

(表面処理用機器事業)

表面処理用機器事業につきましては、利益率の高い装置が検収となったことから、売上高は28億5百万円（前年同期比17.5%減）、営業利益3億22百万円（前年同期比360.4%増）となりました。

(2) 当四半期の財政状態の概況

(資産)

当第3四半期連結会計期間末における流動資産は400億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億32百万円増加しました。主な要因は、「受取手形及び売掛金」の減少14億5百万円、「現金及び預金」の増加21億8百万円によるものであります。有形固定資産は70億1百万円となり、前連結会計年度末より5百万円減少しました。主な要因は、「その他」の増加2億76百万円、「建物及び構築物」の減少1億58百万円、「機械装置及び運搬具」の減少1億34百万円によるものであります。無形固定資産は1億45百万円となり、前連結会計年度末より12百万円減少しました。主な要因は、「ソフトウェア」の減少6百万円、「その他」の減少5百万円によるものであります。投資その他の資産は8億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ22百万円増加しました。主な要因は、「投資有価証券」の減少44百万円、「繰延税金資産」の増加51百万円、「その他」の増加15百万円によるものであります。

これらの結果、当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ6億36百万円増加し、480億65百万円となりました。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末における流動負債は176億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ37億25百万円の減少となりました。主な要因は、「短期借入金」の減少37億10百万円によるものであります。固定負債は74億5百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億53百万円の増加となりました。主な要因は、「長期借入金」の増加14億48百万円によるものであります。

これらの結果、当第3四半期連結会計期間末の負債総額は、前連結会計年度末に比べ22億72百万円減少し、250億60百万円となりました。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は230億5百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億9百万円の増加となりました。主な要因は、「利益剰余金」の増加27億38百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想については、2024年2月13日に公表いたしました「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の2024年12月期の連結業績予想(2024年1月1日～2024年12月31日)を達成する見込みであり、変更はしておりません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,899,779	9,008,028
受取手形及び売掛金	5,674,454	4,268,610
電子記録債権	2,712,839	3,503,009
棚卸資産	22,173,970	22,353,850
その他	1,959,636	919,670
流動資産合計	39,420,680	40,053,170
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3,765,877	3,607,860
機械装置及び運搬具(純額)	1,126,533	992,283
土地	1,288,477	1,298,494
その他(純額)	826,849	1,103,125
有形固定資産合計	7,007,738	7,001,764
無形固定資産		
ソフトウェア	106,467	100,076
その他	51,307	45,398
無形固定資産合計	157,774	145,475
投資その他の資産		
投資有価証券	66,921	22,861
繰延税金資産	359,900	411,090
その他	420,639	436,329
貸倒引当金	△4,797	△4,924
投資その他の資産合計	842,665	865,357
固定資産合計	8,008,177	8,012,597
資産合計	47,428,858	48,065,767

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,098,819	1,916,266
電子記録債務	4,097,812	3,413,544
短期借入金	6,436,717	2,725,820
未払金	1,472,832	1,007,897
未払法人税等	1,023,245	765,454
契約負債	5,246,027	6,388,368
賞与引当金	328,488	619,849
製品保証引当金	454,568	480,157
株式給付引当金	6,869	7,828
有償支給取引に係る負債	—	1,420
その他	214,981	328,034
流動負債合計	21,380,362	17,654,641
固定負債		
長期借入金	5,075,329	6,523,620
株式給付引当金	284,299	306,551
役員退職慰労引当金	25,179	29,182
退職給付に係る負債	68,343	70,947
資産除去債務	187,778	195,695
その他	311,762	279,880
固定負債合計	5,952,693	7,405,877
負債合計	27,333,055	25,060,519
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,556,896	3,568,590
資本剰余金	3,415,301	3,426,995
利益剰余金	12,197,637	14,936,071
自己株式	△311,894	△296,156
株主資本合計	18,857,940	21,635,501
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	30	△263
為替換算調整勘定	909,862	1,016,758
その他の包括利益累計額合計	909,892	1,016,495
非支配株主持分	327,969	353,251
純資産合計	20,095,803	23,005,248
負債純資産合計	47,428,858	48,065,767

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年9月30日)
売上高	19,034,138	24,739,724
売上原価	13,089,950	16,078,238
売上総利益	5,944,187	8,661,486
販売費及び一般管理費	3,539,180	4,060,342
営業利益	2,405,007	4,601,144
営業外収益		
受取利息	28,815	33,537
為替差益	292,099	—
補助金収入	1,164	918
その他	12,093	14,261
営業外収益合計	334,173	48,718
営業外費用		
支払利息	42,689	59,620
為替差損	—	58,820
その他	6,307	7,414
営業外費用合計	48,996	125,855
経常利益	2,690,183	4,524,006
特別利益		
固定資産売却益	14,789	3,756
特別利益合計	14,789	3,756
特別損失		
投資有価証券評価損	335,030	43,862
減損損失	—	100,011
特別退職金	—	33,218
特別損失合計	335,030	177,092
税金等調整前四半期純利益	2,369,942	4,350,670
法人税等	786,692	1,226,253
四半期純利益	1,583,249	3,124,416
非支配株主に帰属する四半期純利益	44,113	29,946
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,539,136	3,094,470

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年9月30日)
四半期純利益	1,583,249	3,124,416
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△256	△293
為替換算調整勘定	628,020	109,777
その他の包括利益合計	627,763	109,483
四半期包括利益	2,211,012	3,233,900
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,131,453	3,201,073
非支配株主に係る四半期包括利益	79,558	32,827

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(四半期連結貸借対照表に関する注記)

1 受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年9月30日)
受取手形裏書譲渡高	一千円	1,140千円

2 電子記録債権譲渡高

	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年9月30日)
電子記録債権譲渡高	265,691千円	55,506千円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年9月30日)
減価償却費	542,858千円	620,705千円

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:千円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	プロセス機器 事業	金型・樹脂 成形事業	表面処理用機 器事業			
売上高						
半導体装置	4,343,215	-	-	4,343,215	-	4,343,215
搬送装置	6,140,584	-	-	6,140,584	-	6,140,584
洗浄装置	2,604,587	-	-	2,604,587	-	2,604,587
コーター	1,408,640	-	-	1,408,640	-	1,408,640
金型・樹脂成形	-	1,137,169	-	1,137,169	-	1,137,169
表面処理用機器	-	-	3,399,940	3,399,940	-	3,399,940
顧客との契約から生じる 収益	14,497,028	1,137,169	3,399,940	19,034,138	-	19,034,138
その他の収益	-	-	-	-	-	-
外部顧客への売上高	14,497,028	1,137,169	3,399,940	19,034,138	-	19,034,138
セグメント間の内部売上 高又は振替高	506,758	493,602	38,095	1,038,457	△1,038,457	-
計	15,003,787	1,630,772	3,438,035	20,072,595	△1,038,457	19,034,138
セグメント利益	2,333,062	19,523	69,972	2,422,558	△17,551	2,405,007

(注) 1. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の調整であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

II 当第3四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:千円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	プロセス機器 事業	金型・樹脂 成形事業	表面処理用機 器事業			
売上高						
半導体装置	9,964,169	-	-	9,964,169	-	9,964,169
搬送装置	5,862,527	-	-	5,862,527	-	5,862,527
洗浄装置	3,756,289	-	-	3,756,289	-	3,756,289
コーター	1,855,970	-	-	1,855,970	-	1,855,970
金型・樹脂成形	-	494,853	-	494,853	-	494,853
表面処理用機器	-	-	2,805,913	2,805,913	-	2,805,913
顧客との契約から生じる 収益	21,438,958	494,853	2,805,913	24,739,724	-	24,739,724
その他の収益	-	-	-	-	-	-
外部顧客への売上高	21,438,958	494,853	2,805,913	24,739,724	-	24,739,724
セグメント間の内部売上 高又は振替高	285,813	193,024	-	478,838	△478,838	-
計	21,724,771	687,877	2,805,913	25,218,562	△478,838	24,739,724
セグメント利益又は損失 (△)	4,491,106	△217,373	322,162	4,595,896	5,247	4,601,144

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の調整であります。

2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

3. 補足情報

(受注状況)

当第3四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

1. 受注高

セグメントの名称	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日) (千円)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年9月30日) (千円)	前年同期比 (%)
プロセス機器事業	15,732,053	14,564,722	92.6
半導体装置	9,106,869	7,389,511	81.1
搬送装置	4,333,399	5,741,447	132.5
洗浄装置	1,080,074	1,134,182	105.0
コーター	1,211,709	299,581	24.7
金型・樹脂成形事業	1,004,901	483,257	48.1
表面処理用機器事業	3,232,210	2,184,788	67.6
合計	19,969,164	17,232,768	86.3

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

2. 受注残高

セグメントの名称	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日) (千円)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年9月30日) (千円)	前年同期比 (%)
プロセス機器事業	30,869,617	24,466,570	79.3
半導体装置	15,073,676	14,840,485	98.5
搬送装置	4,211,638	4,243,231	100.8
洗浄装置	7,119,746	3,612,021	50.7
コーター	4,464,555	1,770,832	39.7
金型・樹脂成形事業	194,194	144,632	74.5
表面処理用機器事業	8,196,403	7,866,047	96.0
合計	39,260,214	32,477,250	82.7

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。